



电子行业研究

买入（维持评级）

行业周报

证券研究报告

电子组

分析师：樊志远（执业 S1130518070003）

fanzhiyuan@gjzq.com.cn

Deepseek 发布 V3.1 模型，继续重点看好 AI 算力硬件

电子周观点：

- **Deepseek 发布 V3.1 模型，继续重点看好 AI 算力硬件。**8月21日，DeepSeek 正式发布最新版本 DeepSeek-V3.1 模型，核心创新在于混合推理能力，支持思考/非思考两种模式切换，效率大幅提升，速度更快，token 消耗减少 20-50%，Agent 能力增强，编程和搜索智能体性能显著提升。DeepSeek-V3.1 模型采用了一种名为 UE8M0 FP8 Scale 的参数精度标准，DeepSeek 官微置顶留言明确表示，这是“针对即将发布的下一代国产芯片设计”，国产算力芯片公司纷纷表示支持 FP8 运算。我们认为，国产大模型持续升级，对 AI 算力需求保持强劲，在算力芯片自主可控的背景下，以 DeepSeek 为首的国产大模型将积极适配国产 AI 芯片，国产算力芯片迎来新的发展机遇。海外算力需求持续强劲，8月22日，鲍威尔讲话偏鸽派，9月降息概率加大，利好 AI 科技行业。建议重点关注英伟达季报及对未来需求展望，博通也将在9月4日发布季报，推理需求大幅增加，ASIC 需求有望超预期。近期，建滔积层板等公司对覆铜板进行提价，此外，PCB 钻针受到 AI 需求（AI-PCB 钻针需求大幅提升）带动及钨粉涨价的驱动，也有涨价的趋势，目前 PCB 钻针龙头公司产能已经打满，供不应求，正在大力扩产。我们认为 GB200 下半年有望快速出货，GB300 也将快速上量，B200、B300 也在积极拉货，产业链迎来拉货旺季，良率提升产能释放后，明年英伟达 NVL72 机架数量也有望超预期。谷歌、亚马逊、Meta 等公司 ASIC 芯片快速发展，预测 2026 年三家公司 ASIC 芯片的数量将超过 700 万颗，OpenAI 及 xAI 等厂商也大力推进 ASIC 芯片。英伟达 Blackwell 快速放量及 ASIC 的大力发展将带动 AI-PCB 需求持续强劲，英伟达也正在积极推进正交背板的研发，若采用 M9 材料，单机架 PCB 价值量将大幅提升，目前多家 AI-PCB 公司订单强劲，满产满销，正大力扩产，下半年业绩高增长有望持续。AI 覆铜板需求旺盛，随着英伟达 GB200 及 ASIC 放量，AI 服务器及交换机大量采用 M8 材料，未来有望向 M9 材料演进，技术升级带来价值量提升，由于海外覆铜板扩产缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益。AI 覆铜板/PCB 的强劲需求也带动了配套设备（钻孔机、直写光刻设备、钻针等）及上游电子布/铜箔等需求。整体来看，继续看好 AI-PCB 及核心算力硬件、苹果链（关注 9 月新机发布亮点）、AI 驱动及自主可控受益产业链。

投资建议与估值

- **看好 AI-PCB 及算力硬件、苹果链、AI 驱动及自主可控受益产业链。**DeepSeek 发布 V3.1 模型，核心创新在于混合推理能力，效率大幅提升，速度更快，token 消耗减少 20-50%。V3.1 模型采用了一种名为 UE8M0 FP8 Scale 的参数精度标准，针对即将发布的下一代国产芯片设计，积极利好国产算力芯片。建议重点关注算力核心受益硬件、AI-PCB 产业链，苹果链（关注 9 月新机发布亮点）、AI 驱动及自主可控受益产业链。
- **细分行业景气指标：**消费电子（稳健向上）、PCB（加速向上）、半导体芯片（稳健向上）、半导体代工/设备/材料/零部件（稳健向上）、显示（底部企稳）、被动元件（稳健向上）、封测（稳健向上）。

风险提示

需求恢复不及预期的风险；AIGC 进展不及预期的风险；外部制裁进一步升级的风险。



一、细分板块观点

1.1 消费电子：影石无人机新品推出，全新产品体验，足够差异化

影翎 Antigravity A1 产品，全球首款全景无人机，搭载影石全景相机核心技术，先飞行再构图，采用飞行眼镜+体验遥控器方式，重量 249g，可折叠携带方便，大部分国家无需培训&考试，支持 8K 30FPS\4K 100FPS。飞行眼镜实现上帝视角沉浸式飞行，体感遥控无需记住复杂的操控按键组合，新手友好度高，计划于 26 年 1 月上市。

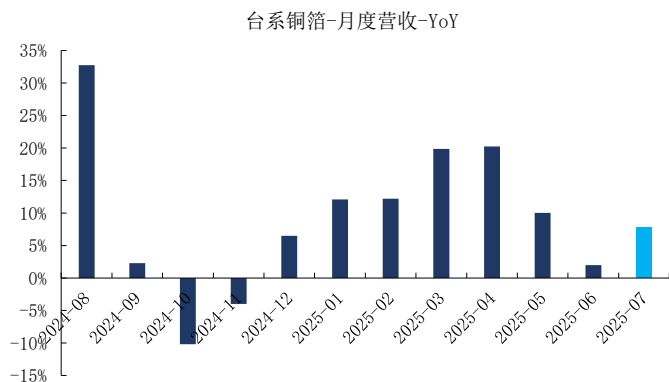
影翎 A1 最核心的产品价值是带来了全新的飞行体验，产品的易用性提升和可玩性会使得无人机产品进一步出圈。基于大疆在无人机统治级的份额和竞争优势，前期市场对于影石无人机并不看好。但从目前影翎新品来看，影石还是基于自身极强的产品定义能力，找到了差异化竞争的方式，这也会是影石未来做更多品类拓展最核心的竞争优势。

建议关注下半年重视消费电子折叠屏机会，1) 明年苹果产品大年核心变化主要在折叠屏新品，其他为微创新；2) 新品导入阶段产业变化较快，密切关注发生边际变化&高附加值环节受益的标的；3) 折叠屏方向下半年催化较多。持续看好苹果产业链机会，苹果 iPhone 开启新一轮创新与成长：AI 赋能，iPhone17 有望在 SOC 芯片 AI 能力提升、散热、FPC 软板、电池及后盖等方面迎来升级及价值量提升，苹果产业链细分龙头公司估值合理，2025-2026 年苹果硬件/端侧模型创新及销量增长趋势确定，预测在 16e、Slim 机型（轻薄款）及折叠手机的带动下，2025-2027 年 iPhone 销量有望稳健增长。

1.2 PCB：延续高景气度，判断景气度为“高景气度维持”

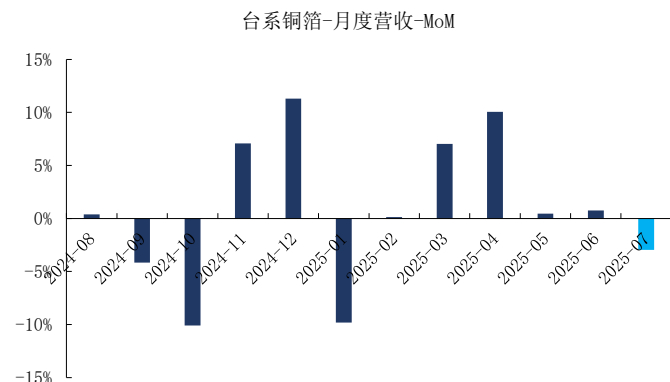
从 PCB 产业链最新数据和 8 月产业链更新来看，整个行业景气度同比均大幅上行，整个产业链景气度判断为“保持高景气度”。根据我们产业链跟踪，主要原因来自于汽车、工控随着政策补贴加持同时 AI 开始大批量放量，并且从当前的能见度观察来看，三季度有望持续保持较高的景气度状态。

图表1：台系电子铜箔厂商月度营收同比增速



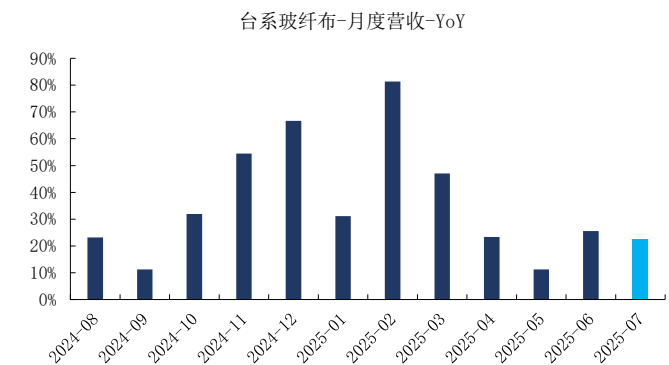
来源：Wind，国金证券研究所

图表2：台系电子铜箔厂商月度营收环比增速



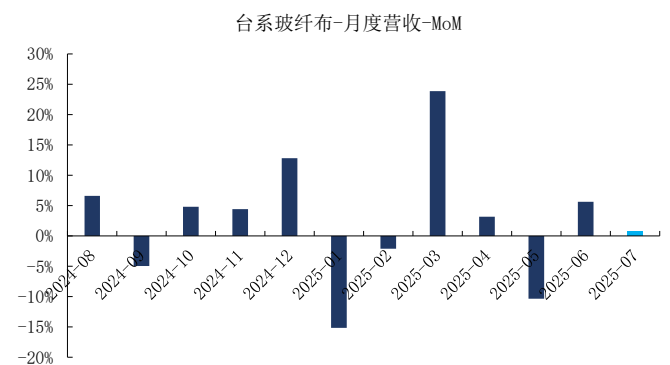
来源：Wind，国金证券研究所

图表3：台系电子玻纤布厂商月度营收同比增速



来源：Wind，国金证券研究所

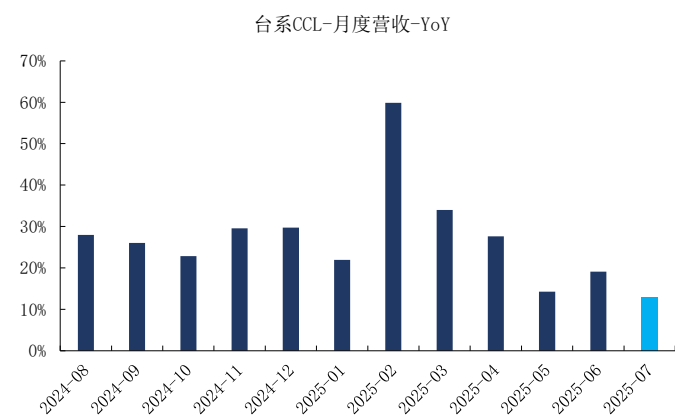
图表4：台系电子玻纤布厂商月度营收环比增速



来源：Wind，国金证券研究所

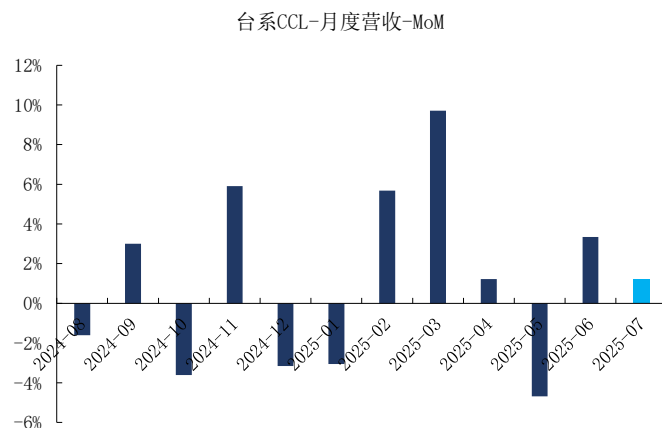


图表5: 台系覆铜板厂商月度营收同比增速



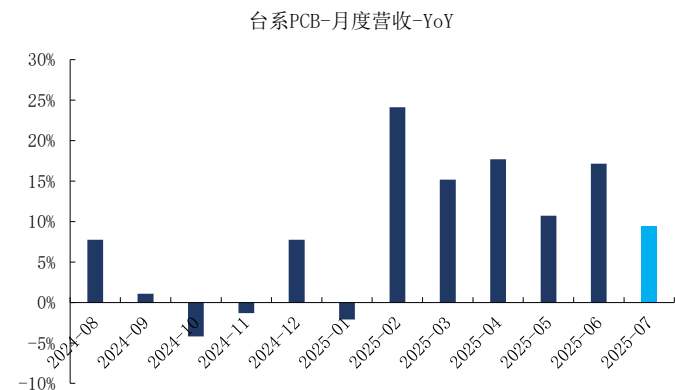
来源: Wind, 国金证券研究所

图表6: 台系覆铜板厂商月度营收环比增速



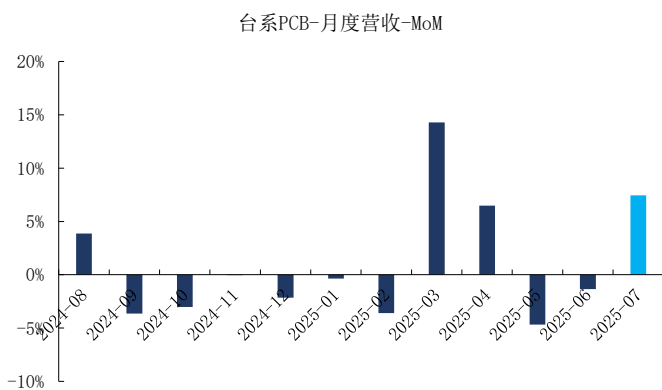
来源: Wind, 国金证券研究所

图表7: 台系 PCB 厂商月度营收同比增速



来源: Wind, 国金证券研究所

图表8: 台系 PCB 厂商月度营收环比增速



来源: Wind, 国金证券研究所

1.3 元件: AI 数据中心 SOFC 供电项目落地, 重点关注三环集团

1) 被动元件

Bloom Energy 宣布将与甲骨文(Oracle)展开合作, 在 90 天内为甲骨文的 AI 数据中心提供现场供电服务。伴随着订单规模爆发&标准化趋势&政府补贴, SOFC 成本持续下降, 建设持续爆发, 对于占地面积&能源效率要求更高的情况下利于 SOFC 渗透。三环集团是 SOFC 隔膜板核心供应商, 公司积极扩产, 伴随 BE AI 数据中心订单爆发公司为 A 股核心受益标的。

AI 端测的升级有望带来估值弹性, AI 手机单机电感用量预计增长, 价格提升; MLCC 手机用量增加, 均价有提升, 主要是产品升级(高容高压耐温、低损耗)。端侧笔电以 WoA 笔电(低能耗见长的精简指令集 RISC, ARM 设计架构)为例, ARM 架构下 MLCC 容值规格提高, 其中 1u 以上 MLCC 用量占总用量近八成, 每台 WoA 笔电 MLCC 总价大幅提高到 5.5~6.5 美金。

2) 面板: LCD 面板价格走弱

LCD: 根据 WitsView 最新面板报价, 7 月 32/43/55/65 吋面板价格变动-1、-1、-2、-3 美金, 6 月份后电视面板需求渐弱的趋势更为明显, 品牌采购态度趋于保守。

OLED: 看好上游国产化机会。国内 OLED 产能释放、高世代线规划带动上游设备材料厂商需求增长+国产替代加速。8.6 代线单线有机发光材料用量远高于 6 代线。有机发光材料技术壁垒高、海外专利垄断, 设备端蒸镀机、掩膜版美日企业主导, 国内供应商正在加速面板厂导入验证, 目前 8.6 代线面板厂规划即三星、LG、京东方、维信诺, 大陆话语权增强也在加速上游国产化进程。国内厂商加速下游面板厂配套合作、导入验证, 建议关注奥来德、莱特光电、京东方 A、维信诺。

1.4 IC 设计: 持续看好景气度上行的存储板块

根据 TrendForce 集邦咨询最新调查, 由于三大 DRAM 原厂将产能转向高阶产品, 并陆续宣布 PC/Server 用 DDR4 以及 Mobile 用 LPDDR4X 进入产品生命周期末期(EOL), 引发市场对旧世代产品积极备货, 叠加传统旺季备货动能, 将推升



2025 年第三季一般型 DRAM (Conventional DRAM) 价格季增 10% 至 15%，若纳入 HBM，整体 DRAM 涨幅将季增 15% 至 20%。

我们看好从 Q2 开始，存储器持续上行的机会：1) 供给端，减产效应显现，存储大厂合约开启涨价。2) 需求端，云计算大厂 capex 投入开始启动，对应企业级存储需求开始增多；同时消费电子终端为旺季备货，补库需求也在加强。整体，我们认为存储器进入明显的趋势向上阶段。我们持续看好企业级存储需求及利基型 DRAM 国产替代，建议关注：兆易创新、香农芯创、北京君正、德明利、江波龙、佰维存储等。

1.5 半导体代工、设备、材料、零部件观点：制裁密集落地，产业链持续逆全球化，自主可控逻辑继续加强

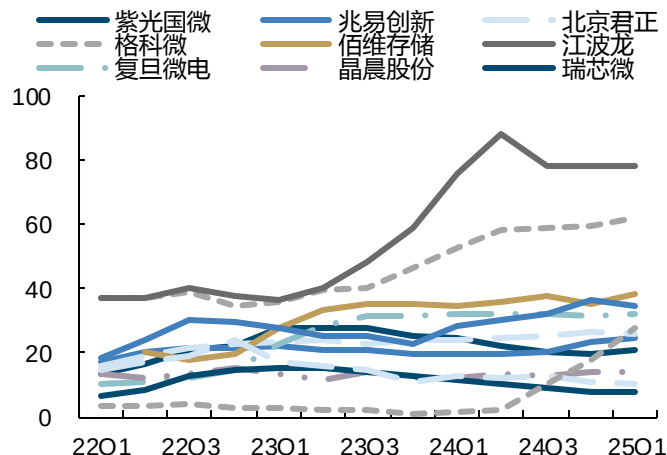
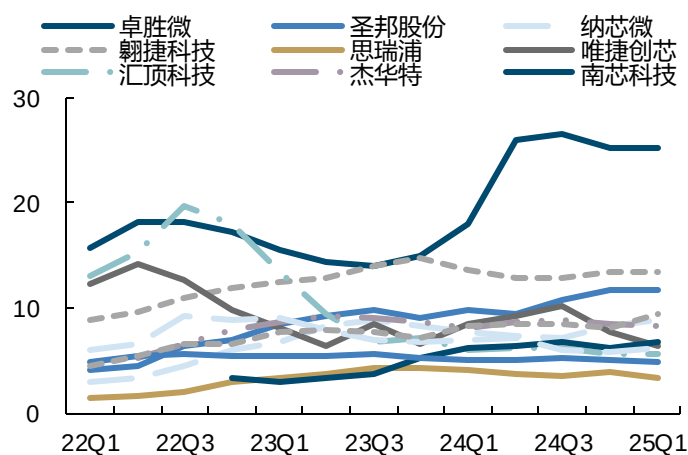
半导体代工、设备、材料、零部件观点：半导体产业链逆全球化，美日荷政府相继正式出台半导体制造设备出口管制措施，半导体设备自主可控逻辑持续加强，为国产半导体产业链逻辑主线。出口管制情况下国内设备、材料、零部件在下游加快验证导入，产业链国产化加速。

封测：先进封装需求旺盛，重视产业链投资机会。算力需求旺盛，地缘政治因素影响下，算力端自主可控成为国产算力核心发展方向。寒武纪、华为昇腾等 AI 算力芯片需求旺盛，先进封装产能紧缺，持续扩产背景下先进封装产业链有望深度受益。此外，HBM 产能紧缺，国产 HBM 已取得突破，看好相关产业链标的。建议关注：长电科技、甬矽电子、通富微电、利扬芯片、伟测科技；封测设备及耗材：华峰测控、金海通、和林微纳。

当前封测板块景气度稳健向上，随下游需求好转，国数模芯片公司库存普遍已筑底回升，开始主动补库。对于封测厂来说，其营收与半导体销售额呈高度拟合关系。从产业链位置来看，封测属半导体产业链中位置相对靠后的环节，封测厂生产的产品将成为最终产品形态并进入设计厂商库存。因此，在库存水位较高的情况下，受 IC 设计厂商砍单影响，封测厂商表现会相对较弱，业绩出现明显下滑；但若当库存水位较低，且下游需求好转情况下，IC 设计厂商会优先向封测厂商加单，加工处理之前积累的未封装晶圆，进而推动整体产业链从底部实现反转。

图表9：部分模拟芯片公司已去库完成，随地缘政治紧张等因素开始进入主动补库阶段（库存，单位：亿元）

图表10：国内部分数字芯片公司库存已筑底回升，随下游需求好转开始主动补库（库存，单位：亿元）



来源：Wind，国金证券研究所

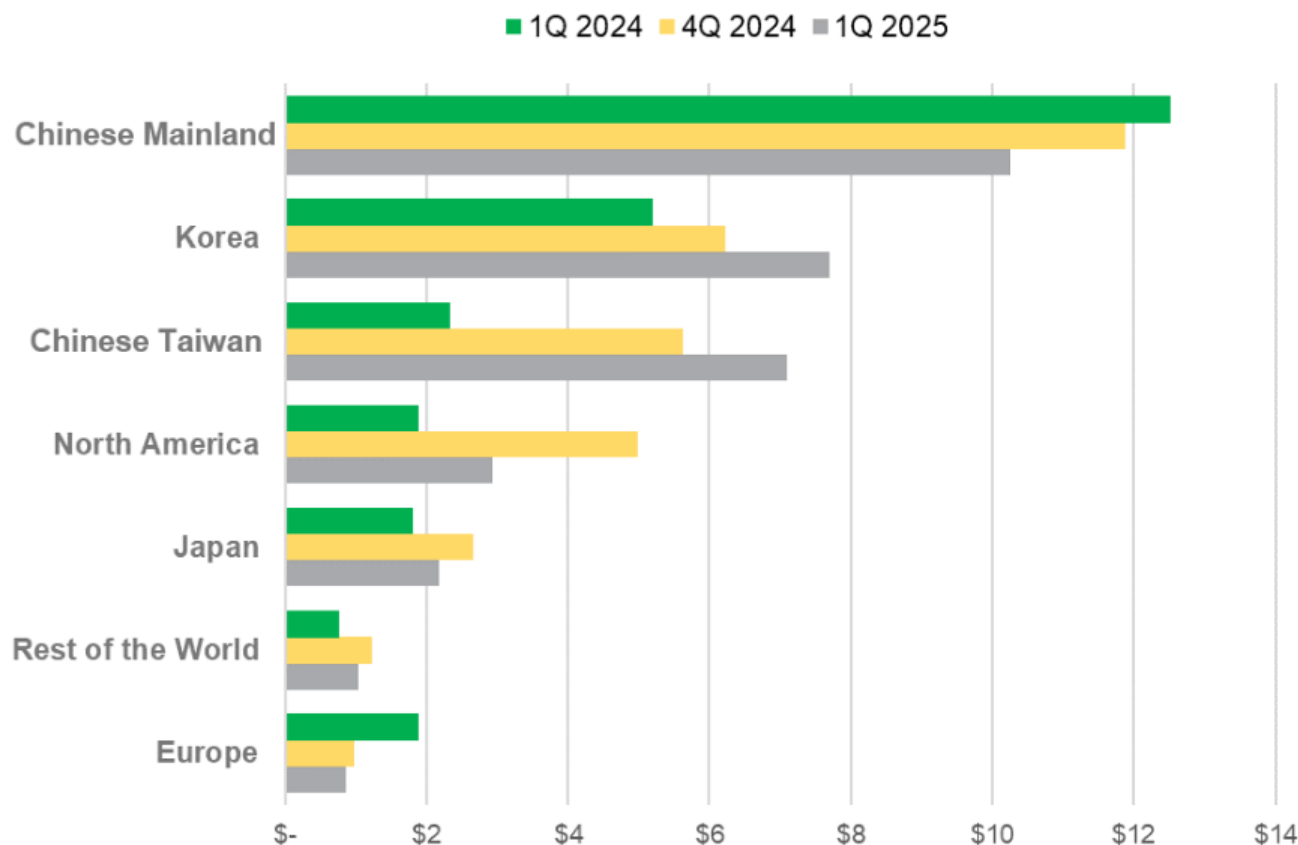
来源：Wind，国金证券研究所

半导体设备板块：半导体设备景气度稳健向上，根据 SEMI 2025 年 6 月 6 日最新发布的报告来看，受益于人工智能热潮及自主可控大趋势，全球半导体设备市场 25 年一季度同比增长 21%，达到 320.5 亿美元，受季节规律影响，环比出现小幅下滑。分区域来看，中国仍是全球半导体设备最大的下游市场，25 年一季度中国大陆半导体设备出货量达 10.26 亿美元，在 24 年高基数的情况下同比下滑 18%。



图表11：尽管 25Q1 中国大陆半导体设备出货量出现下滑，但仍是半导体设备最大的下游市场

Semiconductor Equipment Billings By Region (US\$B)



来源：SEMI，国金证券研究所

后续，我们看好国内存储大厂及先进制程扩产加速落地，建议关注订单弹性较大的【北方华创/拓荆科技/中微公司/华海清科/京仪装备】；另一方面消费电子补库，半导体需求端也在持续改善，随着周期走出底部，一些成熟制程大厂的资本开支有望重新启动，自主可控叠加复苏预期，我们持续看好设备板块。此外，部分国产化率较低设备 25 年或将有所突破，建议关注【芯源微/中科飞测/精测电子】。

半导体材料：看好稼动率回升后材料边际好转及自主可控下国产化的快速导入。材料相对后周期，行业β会受到一些半导体行业景气度的影响，三季报来看，材料端营收利润环比弱复苏。当前美国杜邦已经在逻辑和存储相应的制裁领域断供，日本加入了设备的制裁，材料风险也在增加。中长期看好平台化材料公司，短期看好光刻胶公司的催化机会，建议关注鼎龙股份、雅克科技、安集科技等。

二、重点公司

重点关注 AI-PCB 及算力硬件、半导体自主可控、苹果链及 AI 驱动受益产业链

DeepSeek 发布 V3.1 模型，核心创新在于混合推理能力，效率大幅提升，速度更快，token 消耗减少 20-50%。V3.1 模型采用了一种名为 UE8MO FP8 Scale 的参数精度标准，针对即将发布的下一代国产芯片设计，积极利好国产算力芯片。建议关注英伟达财报及博通财报（ASIC 展望有望超预期）。AI-PCB 迎来需求共振，目前多家 AI-PCB 公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，下半年业绩高增长有望持续。AI 覆铜板也需求旺盛，随着英伟达 GB200 及 ASIC 的放量，AI 服务器及交换机大量转向采用 M8 材料，未来有望采用 M9 材料，由于海外 AI 覆铜板扩产缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益，看好核心受益公司。建议重点关注算力核心受益硬件、AI-PCB 产业链，苹果链（关注 9 月新机发布亮点）、AI 驱动及自主可控受益产业链。重点公司：生益科技、寒武纪、海光信息、兆易创新、胜宏科技、建滔积层板、东山精密、沪电股份、工业富联、生益电子、瑞芯微、鹏鼎控股、鼎泰高科、蓝特光学、景旺电子、深南电路、瑞可达、立讯精密、蓝思科技、华勤技术、安集科技、江丰电子、水晶光电、汇成真空、北方华创、中微公司、思特威、恒玄科技、鼎龙股份、领益智造、东睦股份、三环集团、顺络电子、传音控股。



沪电股份：AI 仍然是当前确定性最强的需求。从海外资本开支预期可看到云计算厂商正在争相在 AI 基础设施布局，根据彭博预期，2025 年 META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分别同比增加 60%、43%、45%、20%，AI 服务器从以往的 14~24 层提升至 20~30 层，交换机提升至 38~46 层，部分产品还会引入 HDI 工艺，行业附加值有望增长。虽然当前海外关税或对出口产业链有影响，但考虑到各大厂商仍在加快布局、AI 硬件产品仍在升级，因此我们认为 AI 相关需求在当前的确定性仍然最高。公司 AI 业务占比快速提升，扩产迎接强劲需求。2024 年公司企业通讯市场板营业收入中（企业通讯市场板占整体收入 75.65%），AI 服务器和 HPC 相关 PCB 产品约占 29.48%；高速网络的交换机及其配套路由相关 PCB 产品约占 38.56%。在 AI 需求进一步加速的情况下，公司也开始加速布局产能，2024 年启动“面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目”和“人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目”。考虑到公司绑定海外高端客户（2024 年境外营收占比 83%、境外毛利占比达到 91%）、不断投入研发以支撑产品升级（2024 年研发费用率达到了 5.9% 的高水平），我们认为公司有望乘 AI 发展东风实现快速发展。

北方华创：受益国产化替代浪潮，看好公司市占率持续提升。美国商务部产业安全局（BIS）在 2024 年 12 月 2 日再次发布新规，针对中国半导体设备施加了新一轮限制。国际形势加速半导体设备国产化替代进程，公司作为国产半导体设备龙头厂商，产品涵盖刻蚀、薄膜沉积、炉管、清洗、快速退火等领域，市场竞争力强劲，有望稳步提升产品市占率。看好后续半导体先进制程及存储厂商扩产。公司作为国内龙头半导体前道设备厂商，产品涉及刻蚀、薄膜沉积、立式炉、外延、清洗等核心工艺制程设备，看好后续国内存储厂商及先进制程扩产下，公司获得重复订单能力。逻辑代工大厂维持高资本开支叠加国内存储大厂年内有望招标扩产，25 年规划内扩产有望逐步落地，公司作为国产半导体设备大厂有望迎来订单及业绩释放大年。持续丰富产品矩阵，平台化布局构筑核心优势。公司在主营产品业务上实现关键突破，成功研发电容耦合等离子体刻蚀设备（CCP）、等离子体增强化学气相沉积设备（PECVD）、原子层沉积立式炉等多款新产品，不断丰富产品矩阵，增强产品布局完善性，进一步巩固行业龙头地位。

恒玄科技：公司自成立以来持续深耕 AIoT 领域，在低功耗、无线连接、音频等方向积累深厚技术底蕴。目前主营产品智能音视频 SoC 芯片广泛应用于智能可穿戴和智能家居在内的各类低功耗场景。公司坚持拓宽品牌客户深度和广度，以此打造竞争优势。目前下游涵盖全球主流安卓手机品牌、专业音频厂商、互联网公司以及家电厂商等四大类客户。公司营收高速增长，盈利能力持续改善，正处于新一轮上升周期。

江丰电子：超高纯靶材业务新品取得突破，精密零部件业务保持高速增长。2024 年，公司超高纯靶材收入达到 23.33 亿元，占总营收比例为 64.73%，同比+39.51%。公司在全球半导体靶材的市场份额进一步扩大，公司研发成果显著，300mm 铜锰合金靶产量大幅攀升；用于先进制程的高致密 300mm 钨靶实现稳定批量供货，高端靶材产品竞争力进一步强化。2024 年，精密零部件业务收入为 8.87 亿元，占比 24.60%，同比+55.53%。公司的精密零部件产品已经在刻蚀、薄膜沉积等半导体核心工艺环节得到广泛应用，可量产 Shower head、Si 电极等 4 万多种零部件，形成全品类零部件覆盖。2024 年公司半导体精密零部件业务毛利率有所下滑，为 24.27%，主要系公司为扩大市场份额和导入新客户在毛利率方面有所让步。随着公司多个生产基地陆续建成投产，以及先进制程的需求增加，公司精密零部件业务将为公司业绩增长注入强劲动力。

中微公司：公司研发力度持续加大，新品开发速度加快。目前公司在研项目涵盖六大类，超过二十款新设备的开发。目前，在高额研发投入支持下，公司相较之前三到五年产品速度，目前只需两年或更短时间就能开发出有竞争力的新设备，并顺利进入市场。1Q25 公司继续维持高额研发投入，研发费用达 6.87 亿元，同比增长 90.53%，研发投入占公司营业收入比例约为 31.60%，显著高于同业公司。刻蚀设备 24 年收入高增，薄膜沉积设备/EPI/量检测等新产品进展良好。根据公司 24 年年报数据显示，24 年公司刻蚀设备收入为 72.77 亿元，同比+54.73%。公司为先进存储器件和逻辑器件开发的六种 LPCVD 薄膜设备已经顺利进入市场，2024 年收到约 4.76 亿元批量订单，实现销售收入已达到 1.56 亿元。新开发的 EPI 设备已顺利进入客户端量产验证阶段，满足客户先进制程中锗硅外延生长工艺的量产需求。此外公司成立子公司“超微公司”，布局量检测设备板块，已规划覆盖多种量检测设备产品，平台型设备公司布局已初步形成。

兆易创新：25Q1 淡季不淡，下游需求强劲。一季度收入和利润双增长主要归因于：1）国补刺激消费电子需求，国家一揽子刺激措施等原因，消费领域需求得以提振；2）AI 带动端侧存储容量升级，受益于 AIPC 等终端对存储容量需求的带动，一季度公司产品在存储与计算领域实现收入和销量大幅增长；此外，公司网通市场也实现较好增长。我们认为“国产替代+端侧 AI”将成为驱动公司未来成长的主要动力。1）利基型存储和 MCU 加速国产替代：此次中美关税事件，将加速推动国内企业进行供应链国产替代，基于外部的不安全性，即便海外产品在某些方面有优势，也难以对冲对供应不安全性的担忧，更别说兆易在 NorFlash、MCU、利基 DRAM 等领域本身技术就领先于竞争对手。此外在利基 DRAM 领域，由于三星、美光、海力士等头部公司为了加速向新制程节点的 HBM、DDR5、LPDDR5 等产品迁移，放弃或减少利基型产品的生产，有望带来行业竞争格局的变化和国内厂商份额提升的机会。2）AI 驱动端侧存储升级：Deepseek 加快了 AI 推理和应用脚步，我们看好不久的将来端侧 AI 有望大规模爆发，包括 AI 耳机、AI 手机、AI 眼镜、AIPC、AI 智能家居等，这将有效带动端侧存储的升级。公司在端侧存储领域有较完善的产品线布局，产品包括 NORFlash、利基型 DRAM 和 SLC NANDFlash 三大品类，有望核心受益。

建滔积层板：需求加速揭开涨价周期，高端品布局有望将盈利水平拔到新高度。1）根据沪电股份 2024 年年报引用的 Prismark 数据，下游 PCB 行业 2024 年同比+5.8%、2025 年预计同比+6.8%；2）台系企业的月度营收保持同比增长；3）IDC 对消费类终端保持增长预期；4）家电和汽车高频数据大幅增长，看好今年需求有望走出加速趋势。2 月底覆铜板及上游原材料纷纷发出涨价函，打响了涨价周期的发令枪，在涨价逻辑的基础上公司盈利存在加速提升的基础，同时公司覆铜板已涉足高速领域、上游原材料已经涉足 low dk 玻纤布和 HVLP3 等级铜箔等高端产品，因此公司的盈利水平有望在本轮周期中拔高到新高度。



蓝特光学：微棱镜收入实现较快增长。2024 年，公司光学校镜业务收入 6.54 亿元，同比增长 59.01%，下游客户智能手机潜望式摄像头模组的微棱镜产品需求增加，带动公司业绩增长；玻璃非球面透镜业务收入 2.51 亿元，同比增长 4.08%，加强产能储备、降本增效，营收规模提升的同时实现了成本规模控制；玻璃晶圆业务收入 0.73 亿元，同比增长 38.91%，加强开发 AR/VR、汽车 LOGO 投影、半导体等领域客户。持续看好公司光学校镜及玻璃非球面透镜业务成长性。终端品牌潜望式规格有望进一步升级，公司有望凭借其生产工艺优势、产能储备、良率水平提升，持续受益于微棱镜渗透和升级。公司具备玻璃晶圆能力，在研发 AR 光波导模组，深度绑定下游龙头客户，看好 AR 智能眼镜光波导方向，公司主要客户提供玻璃晶圆，显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成 AR 光波导，最终用作 AR 镜片材料，公司亦可根据下游客户需求，在显示玻璃晶圆进行通孔、切割、光刻等深加工。玻璃非球面透镜业务增长空间广阔，汽车智能化推动车载 ADAS 及高清摄像头逐渐渗透，公司深度绑定智能汽车头部供应商及客户。

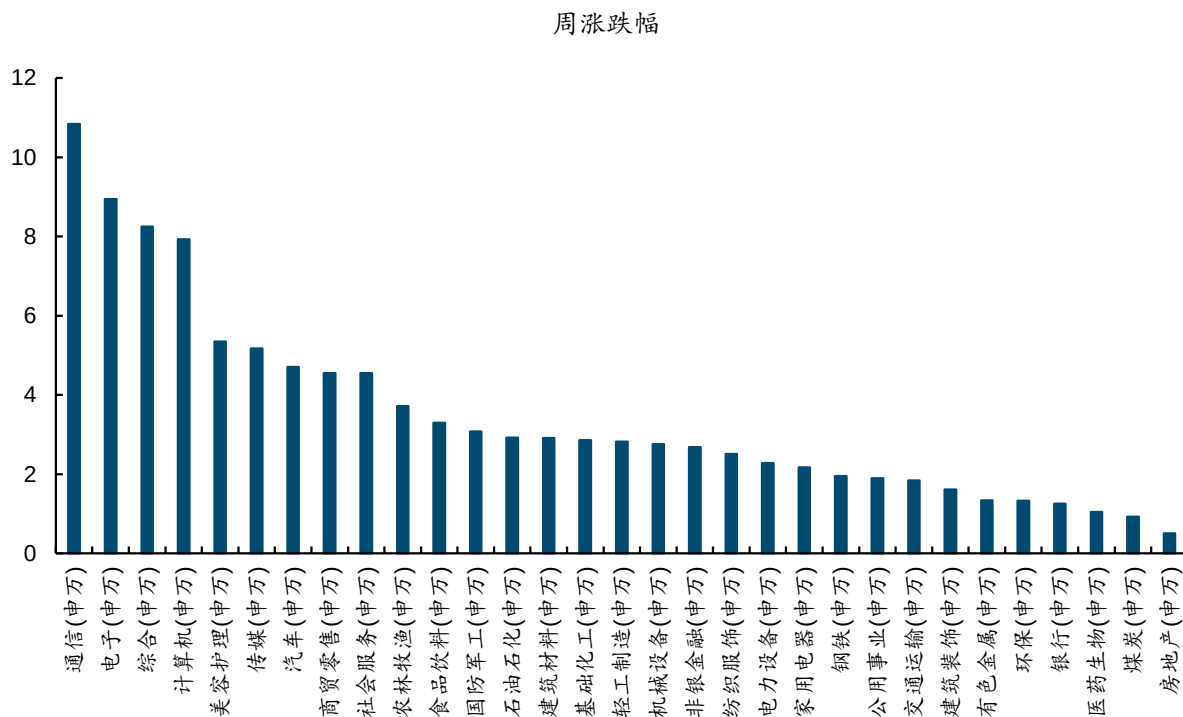
传音控股：收入增速稳健，盈利水平有所承压，2024 年公司手机业务毛利率为 20.62%，同比下滑 2.63pct，非洲地区毛利率为 28.59%，同比下滑 1.46pct，亚洲及其他地区毛利率为 17.66%，同比下滑 2.52pct，毛利率下滑主要系市场竞争以及供应链成本综合影响。预计未来随着公司产品高端化方向持续发力、进一步加强供应链成本管理水平，公司盈利水平有望提升。2024 年，公司持续开拓新兴市场及推进产品升级，整体出货量有所增加。2024 年，公司手机整体出货量约 2.01 亿部，根据 IDC 数据，2024 年公司全球手机市占率为 14.0%，在全球手机品牌厂商中排名第三，其中全球智能手机市占率为 8.7%，排名第四。非洲市场地位领先，新兴市场有较大成长潜力。根据 IDC 数据，2024 年公司在非洲智能机市占率超过 40%，排名第一，南亚市场在巴基斯坦智能机市占率超过 40%，排名第一；孟加拉国智能机市占率 29.2%，排名第一；印度智能机市占率为 5.7%，排名第八。公司基于其在新兴市场积累的领先优势，推进多元化战略布局，在新兴市场开展了数码配件、家用电器等扩品类业务以及提供移动互联网产品及服务。

汇成真空：真空镀膜设备为公司贡献主要营收，在手订单饱满。2025H1 公司的真空镀膜设备实现销售收入 2.63 亿元（同比+9.52%），占比达 89.11%；配件及耗材业务实现收入 1300 万元（同比-79.63%）。2025H1 公司在建工程金额为 994.25 万元，较 2024 年末增长 603.50%。截至 2025 年上半年，公司合同负债金额为 1.92 亿元，较上一年末增长 24.68%，在手订单饱满。2025H1 公司的研发费用率为 6.02%，研发投入力度略有增长。2025 年上半年公司参与制定“金属及其他无机覆盖层工程用直流磁控溅射银镀层镀层附着力的测量（GB/T45345-2025）”国家标准，完成了“半导体行业 PVD 研发设备开发”研发项目结案，完成了“DPLEBS-1100 精密电子束蒸发光学镀膜设备研发”、“槽孔镀干涉色项目开发”、“非导体材料金属化的真空镀膜设备开发及工艺研究”、“PECVD 镀膜系统升级 ALD 功能合作开发”、“HCIBS-1100 离子束溅射镀膜设备开发及工艺研究”、“极紫外多层膜镀膜工艺研究”等研发项目立项。

三、板块行情回顾

回顾本周行情，参考申万一级行业划分，涨跌幅前三名的行业分别为通信、电子、综合，涨跌幅分别为 10.84%、8.95%、8.25%。涨跌幅后三位为医药生物、煤炭、房地产，涨跌幅分别为 1.05%、0.92%、0.50%。本周电子行业涨跌幅为 8.95%。

图表12：板块周涨跌幅排序（单位：%）（2025.8.18-2025.8.22）

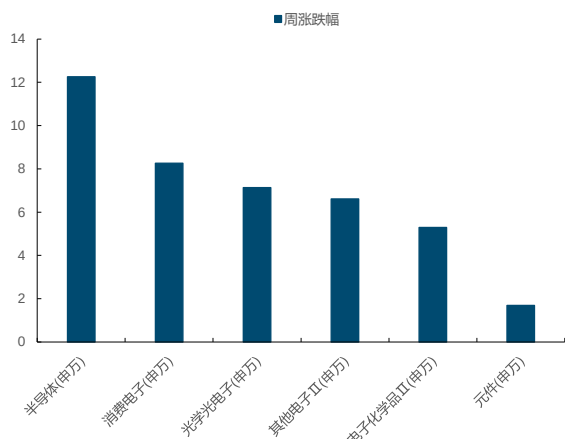


来源：Wind，国金证券研究所



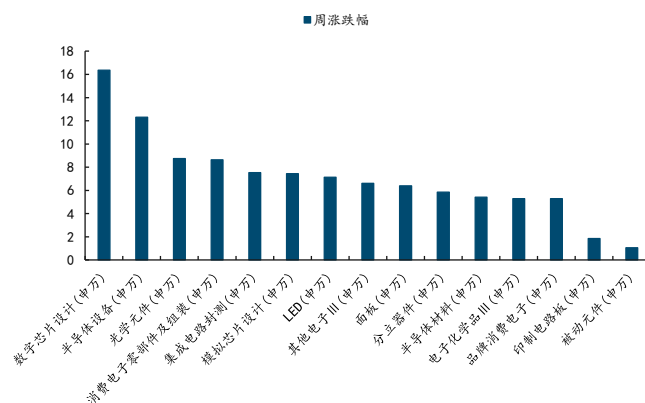
在电子细分板块中，涨跌幅前三大细分板块为半导体、消费电子、光学光电子，涨跌幅分别为 12.25%、8.25%、7.13%。涨跌幅靠后的三大细分板块为品牌其他电子 II、电子化学品 II、元件，涨跌幅分别为 6.60%、5.29%、1.68%。

图表13：申万二级电子细分板块周涨跌幅（单位：%）
（2025.8.18-2025.8.22）



来源：Wind，国金证券研究所

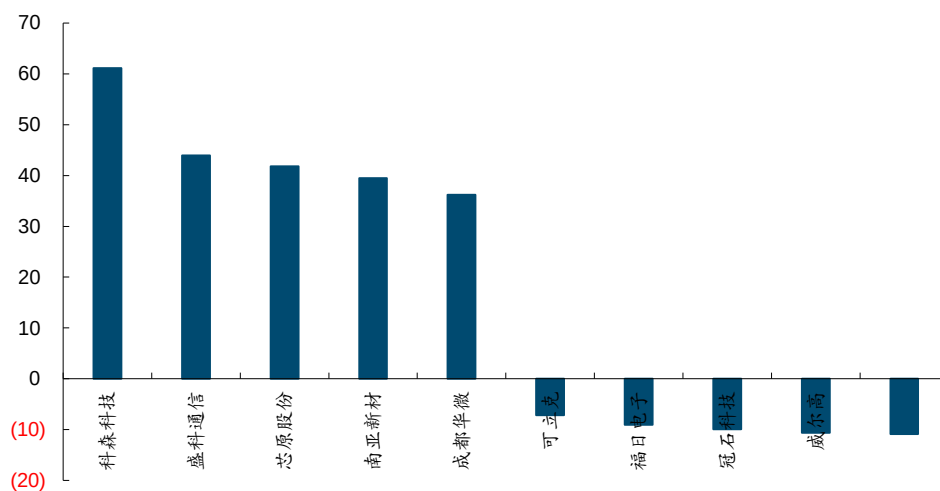
图表14：申万三级电子细分板块周涨跌幅（单位：%）
（2025.8.18-2025.8.22）



来源：Wind，国金证券研究所

从个股情况来看，本周科森科技，盛科通信，芯原股份，南亚新材，成都华微为涨幅前五大公司，涨幅分别为 61.14%、43.95%、41.79%、39.48%、36.23%。跌幅前五为可立克，福日电子，冠石科技，威尔高，久量股份，跌幅分别为-7.17%、-9.03%、-9.91%、-10.62%、-10.90%。

图表15：电子板块个股周涨跌幅（%）（2025.8.18-2025.8.22）



来源：Wind，国金证券研究所

四、风险提示

AIGC 进展不及预期的风险：科技巨头公司布局 AI，存在未来行业竞争进一步加剧、AI 产品不能有效与应用实践相结合的风险。

外部制裁进一步升级的风险：全球范围内的贸易摩擦不断升级，若美国、日本、荷兰等国出口管制进一步升级，可能会导致相关企业的核心环节受限。

终端需求不及预期的风险：消费类智能手机创新乏力，对产业链拉动低于预期，换机周期较长；若新能源（电动汽车、风电、光伏、储能）需求不及预期，电动车销量下滑，光储装机量不及预期，可能会对相关公司业绩产生影响。



行业投资评级的说明：

买入：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 15%以上；

增持：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 5%—15%；

中性：预期未来 3—6 个月内该行业变动幅度相对大盘在 -5%—5%；

减持：预期未来 3—6 个月内该行业下跌幅度超过大盘在 5%以上。



特别声明：

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海	北京	深圳
电话：021-80234211	电话：010-85950438	电话：0755-86695353
邮箱：researchsh@gjzq.com.cn	邮箱：researchbj@gjzq.com.cn	邮箱：researchsz@gjzq.com.cn
邮编：201204	邮编：100005	邮编：518000
地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号 紫竹国际大厦 5 楼	地址：北京市东城区建国门内大街 26 号 新闻大厦 8 层南侧	地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 18 楼 1806



【小程序】
国金证券研究服务



【公众号】
国金证券研究